BEST AVAILABLE COPY

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2003-183227

(43) Date of publication of application: 03.07.2003

(51)Int.CI.

C07C 69/96G03F 7/004 G03F 7/039

H01L 21/027

(21)Application number: 2002-284316

(71)Applicant: OSAKA INDUSTRIAL PROMOTION

ORGANIZATION

(22)Date of filing:

27.09.2002

(72)Inventor: SHIROTA YASUHIKO

KAGEYAMA HIROSHI KADOTA TOSHIAKI

(30)Priority

Priority number: 2001306279 Priority date: 02.10.2001

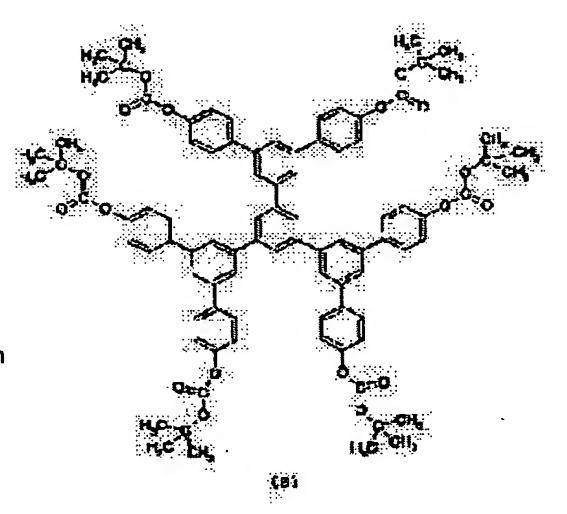
Priority country: JP

(54) NEW ORGANIC COMPOUND

(57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a new organic compound capable of being used as a resist material capable of producing a pattern having a high sensitivity and high resolution.

SOLUTION: This organic compound e.g. expressed by the following formula (1) has a functional group releasable by an acid. The organic compound has an extremely small molecular size as compared with a polymeric compound (from several hundreds to several thousands), and can form the pattern having the high sensitivity and high resolution by utilizing a chemical amplification. By dissolving the organic compound and an acid-forming agent in a solvent and applying the obtained solution on a silicone substrate, etc., the resist material with an amorphous thin film is formed, and can be made as a resist substrate. By irradiating light, an electron beam or radiation to the resist substrate to draw an image and developing by using an alkaline developing agent, the pattern having the high sensitivity and high resolution can be formed.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than

the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(12)公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開2003-183227

(P2003-183227A)

(43)公開日 平成15年7月3日(2003.7.3)

(51) Int. Cl. ⁷	識別記号	FI			テーマコート'	(参考)
C07C 69/96		C07C 69/96		Z	2H025	
G03F 7/004	501	G03F 7/004	501		4H006	
7/039	601	7/039	601			
H01L 21/027		H01L 21/30	502	R		
						•

審査請求 未請求 請求項の数28 OL (全15頁)

(21)出願番号 特願2002-284316(P2002-284316)

(22)出願日 平成14年9月27日(2002.9.27)

(31)優先権主張番号 特願2001-306279(P2001-306279)

(32)優先日 平成13年10月2日(2001.10.2)

(33)優先権主張国 日本(JP)

特許法第30条第1項適用申請有り 平成13年8月28日 社団法人高分子学会発行の「高分子学会予稿集 50巻12⁻ 号」に発表 (71)出願人 801000061

財団法人大阪産業振興機構

大阪府大阪市中央区本町橋2番5号 マイ

ドームおおさか内

(72)発明者 城田 靖彦

大阪府豊中市大黒町3-5-7

(72)発明者 景山 弘

大阪府豊中市曽根東町6-5-8-202

(74)代理人 110000040

特許業務法人池内・佐藤アンドパートナー

ズ

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】新規有機化合物

(57)【要約】

【課題】 高感度・高解像度パターンを作製可能なレジスト材料に使用できる新規有機化合物を提供する。

【解決手段】 本発明の化合物は、例えば下記式で表されるように、酸解離性官能基を有する有機化合物である。本発明の有機化合物は、高分子化合物に比べて分子サイズが極めて小さく(数百から数千程度)、さらに化学増幅を利用することにより、高感度・高解像度のパターン形成が可能である。本発明の有機化合物および酸発生剤を溶媒に溶かし、シリコン基板等の上に塗布することにより、アモルファス薄膜によるレジスト材料を形成し、レジスト基板とすることができる。このレジスト基板に光、電子線または放射線を照射して描画し、アルカリ現像液を用いて現像することにより、高感度・高解像度のパターンを形成することができる。

【化4】

【特許請求の範囲】

下記一般式 (1) で表される有機化合 【請求項1】 物。

【化1】

ただし、式中、 $A^1 \sim A^{12}$ は任意の置換基であるが、そ れらの中で少なくとも一つは存在し、そして、A¹~A 12のうち少なくとも一つは酸解離性官能基である。

【請求項2】 前記式(1)中、A¹~A¹²が、水素お よび下記一般式(2)~(4)で表される置換基からな る群から選択される少なくとも一種類である請求項1に 20 記載の有機化合物。

$$(2) \qquad (3) \qquad (4)$$

ただし、前記式(2)~(4)中、Yは1から12まで の整数であり、R'、R'およびR'は、Yが同一であ るA'に対応し、ここで、A'は、前記A'~A'2のいず れかであり、

R¹~R¹²は、それぞれ水素、無置換もしくは置換メチ ル基、無置換もしくは1-置換エチル基、無置換もしく は1-置換-n-プロピル基、1-分枝アルキル基、シ リル基、アシル基、アルコキシカルボニル基、無置換も しくは1-置換アルコキシメチル基、または環状置換基 であり、同一でも異なっていても良く、

R¹~R¹²はそれぞれ無置換または置換ジメチレン基 であり、同一でも異なっていても良く、

 $R_{\mathfrak{g}}^{1} \sim R_{\mathfrak{g}}^{12}$ はそれぞれ電子吸引基であり、同一でも異 なっていても良く、

そして、A¹~A¹²のうち少なくとも一つは水素以外の 前記原子団であり、および、R¹~R¹²のうち少なくと も一つは水素以外の前記原子団である。

【請求項3】前記式(2)~(4)中、 $R^1 \sim R^{12}$ において、

置換メチル基が、メトキシメチル基、メチルチオメチル 基、エトキシメチル基、エチルチオメチル基、メトキシ エトキシメチル基、ベンジルオキシメチル基、ベンジル チオメチル基、フェナシル基、4-ブロモフェナシル

基、4-メトキシフェナシル基、ピペロニル基、メトキ シカルボニルメチル基、エトキシカルボニルメチル基、 nープロポキシカルボニルメチル基、iープロポキシカル ボニルメチル基、nーブトキシカルボニルメチル基およ びtーブトキシカルボニルメチル基からなる群から選択 される少なくとも一種類であり、

1-置換エチル基が、1-メトキシエチル基、1-メチル チオエチル基、1,1-ジメトキシエチル基、1-エトキ シエチル基、1-エチルチオエチル基、1, 1-ジエトキ 10 シエチル基、1-フェノキシエチル基、1-フェニルチオ エチル基、1,1-ジフェノキシエチル基、1-シクロペ ンチルオキシエチル基、1-シクロヘキシルオキシエチ ル基、1-フェニルエチル基および1、1-ジフェニルエ チル基からなる群から選択される少なくとも一種類であ り、

1-置換-n-プロピル基が、1-メトキシ-n-プロピル 基および1-エトキシーn-プロピル基からなる群から選 択される少なくとも一種類であり、

1-分枝アルキル基が、iープロピル基、Secーブチ ル基、tーブチル基、1,1-ジメチルプロピル基、1-メ チルブチル基および1、1-ジメチルブチル基からなる群 から選択される少なくとも一種類であり、

シリル基が、トリメチルシリル基、エチルジメチルシリ ル基、メチルジエチルシリル基、トリエチルシリル基、 tーブチルジメチルシリル基、tーブチルジエチルシリル 基、tーブチルジフェニルシリル基、トリーtーブチルシ リル基およびトリフェニルシリル基からなる群から選択 される少なくとも一種類であり、

アシル基が、アセチル基、フェノキシアセチル基、プロ 30 ピオニル基、ブチリル基、ヘプタノイル基、ヘキサノイ ル基、バレリル基、ピバロイル基、イソバレリル基、ラ ウリロイル基、ベンゾイル基およびナフトイル基からな る群から選択される少なくとも一種類であり、

アルコキシカルボニル基が、メトキシカルボニル基、エ トキシカルボニル基、nープロポキシカルボニル基、iー プロポキシカルボニル基、nーブトキシカルボニル基お よびtーブトキシカルボニル基からなる群から選択され る少なくとも一種類であり、

1-置換アルコキシメチル基が、1-シクロペンチルメト 40 キシメチル、1ーシクロペンチルエトキシメチル、1ーシ クロヘキシルメトキシメチル、1-シクロヘキシルエト キシエチル、1-シクロオクチルメトキシメチルおよび1 ーアダマンチルメトキシメチル基からなる群から選択さ れる少なくとも一種類であり、

環状置換基が、シクロペンチル基、シクロヘキシル基、 シクロヘキセニル基、アダマンチル基、4ーメトキシシ クロヘキシル基、テトラヒドロピラニル基、テトラヒド ロフラニル基、テトラヒドロチオピラニル基、テトラヒ ドロチオフラニル基、4-メトキシテトラヒドロピラニ 50 ル基および4ーメトキシテトラヒドロチオピラニル基か

らなる群から選択される少なくとも一種類であり、 そして、

5

R¹~R¹²が、ジメチレン基、メトキシジメチレン 基、メチルチオジメチレン基、ジメトキシジメチレン 基、エトキシジメチレン基、エチルチオジメチレン基、 ジエトキシジメチレン基、フェノキシジメチレン基、フ ェニルチオジメチレン基、ジフェノキシジメチレン基、 シクロペンチルオキシジメチレン基、シクロヘキシルオ キシジメチレン基、フェニルジメチレン基およびジフェ ニルジメチレン基からなる群から選択される少なくとも 10 シルメトキシメチル基からなる群から選択される少なく 一種類である、請求項2に記載の有機化合物。

【請求項4】 前記式(4)中、R₈'~R₈'²が、それ ぞれシアノ基、アルコキシスルホニル基、アシル基、ま たはアルコキシカルボニル基であり、同一であるかまた は異なる請求項2または3に記載の有機化合物。

【請求項5】R_B¹~R_B¹²において、

アルコキシスルホニル基が、メトキシスルホニル基、エ トキシスルホニル基、nープロポキシスルホニル基、iー プロポキシスルホニル基、nーブトキシスルホニル基お よびtーブトキシスルホニル基からなる群から選択され る少なくとも一種類であり、

アシル基が、アセチル基、フェノキシアセチル基、プロ ピオニル基、ブチリル基、ヘプタノイル基、ヘキサノイ ル基、バレリル基、ピバロイル基、イソバレリル基、ラ ウリロイル基、ベンゾイル基およびナフトイル基からな る群から選択される少なくとも一種類であり、

アルコキシカルボニル基が、メトキシカルボニル基、エ トキシカルボニル基、nープロポキシカルボニル基、iー プロポキシカルボニル基、nーブトキシカルボニル基お よびtーブトキシカルボニル基からなる群から選択され る少なくとも一種類である、請求項4に記載の有機化合 物。

【請求項6】 A¹~A¹²が、水素および前記一般式

(2)で表される置換基からなる群から選択される少な くとも一種類であり、

R¹~R¹²が、水素、メトキシカルボニル基、エトキシ カルボニル基、nープロポキシカルボニル基、iープロポ キシカルボニル基、nーブトキシカルボニル基、tーブト キシカルボニル基、tーブトキシカルボニルメチル基、1 ーメトキシエチル基、1ーエトキシエチル基、1ーシクロ ヘキシルオキシエチル基、tーブチル基、トリメチルシ リル基、テトラヒドロピラニル基および1ーシクロヘキ とも一種類である、請求項2に記載の有機化合物。

【請求項7】 A¹~A¹²が、水素および前記一般式 (4)で表される置換基からなる群から選択される少な くとも一種類である、請求項2から5のいずれかに記載 の有機化合物。

【請求項8】 下記一般式(5)で表される請求項1か 「ら7のいずれかに記載の有機化合物。

【化3】

下記式(6)で表される請求項8に記載 【請求項9】 の有機化合物。

(5)

30

【請求項10】 請求項1から9のいずれかに記載の化合物のうち少なくとも一種類と、酸発生剤とを含む組成物。

【請求項11】 前記酸発生剤が、光、電子線または放射線により直接的または間接的に酸を発生する化合物である請求項10に記載の組成物。

【請求項12】 前記酸発生剤が、下記一般式 (7) ~ (11)で表される化合物からなる群から選択される少なくとも一種類である請求項10または11に記載の組成物。

【化5】

【化6】

$$R^{23}$$
 R^{24}
 R^{25}
 R^{26}
 R^{27}

【化7】

$$V < C > N - O - S - R^{28}$$
 $O = C > N - O - S - R^{28}$
 $O = C > O = C > O$
 $O = C$
 $O = C$

【化8】

【化9】

(11)

(10)

(8)

ただし、式中、

R¹³~R²¹は、それぞれ水素原子、直鎖状、分枝状もしくは環状アルキル基、直鎖状、分枝状もしくは環状アルコキシ基、ヒドロキシル基またはハロゲン原子であり、同一でも異なっていても良く、

X は、アルキル基、アリール基、ハロゲン置換アルキル基もしくはハロゲン置換アリール基を有するスルホン酸イオン、またはハロゲン化物イオンであり、

R²²~R²⁷は、それぞれ水素原子、直鎖状、分枝状もし 50 チルスルホニウムトリフルオロメタンスルホネート、ジ

くは環状アルキル基、直鎖状、分枝状もしくは環状アルコキシ基、ヒドロキシル基またはハロゲン原子であり、同一でも異なっていても良く、

Vはアルキレン基、アリーレン基またはアルコキシレン 基であり、

R²⁸はアルキル基、アリール基、ハロゲン置換アルキル 基またはハロゲン置換アリール基であり、

R²⁹およびR³⁰は、それぞれ、任意に置換された直鎖、 分枝もしくは環状アルキル基、任意に置換されたアリー 10 ル基、任意に置換されたヘテロアリール基または任意に 置換されたアラルキル基であり、同一でも異なっていて も良く、

R³¹およびR³²は、それぞれ、任意に置換された直鎖、 分枝もしくは環状アルキル基、任意に置換されたアリー ル基、任意に置換されたヘテロアリール基または任意に 置換されたアラルキル基であり、同一でも異なっていて も良い。

【請求項13】前記式(7)で表される化合物が、トリー フェニルスルホニウムトリフルオロメタンスルホネー 20 ト、トリフェニルスルホニウムノナフルオローnーブタ ンスルホネート、トリフェニルスルホニウムパーフルオ ローnーオクタンスルホネート、ジフェニルー4ーメチ ルフェニルスルホニウムトリフルオロメタンスルホネー ト、ジー2,4,6ートリメチルフェニルスルホニウム トリフルオロメタンスルホネート、ジフェニルー4-t ーブトキシフェニルスルホニウムトリフルオロメタンス ルホネート、ジフェニルー4-t-ブトキシフェニルス ルホニウムノナフルオローnーブタンスルホネート、ジ フェニルー4ーヒドロキシフェニルスルホニウムトリフ 30 ルオロメタンスルホネート、ビス(4-フルオロフェニ ル) -4-ヒドロキシフェニルスルホニウムトリフルオ ロメタンスルホネート、ジフェニルー4ーヒドロキシフ ェニルスルホニウムノナフルオローnーブタンスルホネ ート、ビス(4ーヒドロキシフェニル)ーフェニルスル ホニウムトリフルオロメタンスルホネート、トリ (4-メトキシフェニル) スルホニウムトリフルオロメタンス ルホネート、トリ(4-フルオロフェニル)スルホニウ ムトリフルオロメタンスルホネート、トリフェニルスル ホニウムpートルエンスルホネート、トリフェニルスル 40 ホニウムベンゼンスルホネート、ジフェニルー2,4, 6-トリメチルフェニル-p-トルエンスルホネート、 ジフェニルー2,4,6ートリメチルフェニルスルホニ ウムー2ートリフルオロメチルベンゼンスルホネート、 ジフェニルー2,4,6-トリメチルフェニルスルホニ ウムー4ートリフルオロメチルベンゼンスルホネート、 ジフェニルー2,4,6ートリメチルフェニルスルホニ ウムー2, 4-ジフルオロベンゼンスルホネート、ジフ エニルー2, 4, 6-トリメチルフェニルスルホニウム ヘキサフルオロベンゼンスルホネート、ジフェニルナフ

フェニルー4ーヒドロキシフェニルスルホニウムーpー トルエンスルホネート、トリフェニルスルホニウム10 ーカンファースルホネートおよびジフェニルー4ーヒド ロキシフェニルスルホニウム10-カンファースルホネ ートからなる群から選択される少なくとも一種類であ り、前記式(8)で表される化合物が、ビス(4-t-ブチルフェニル) ヨードニウムトリフルオロメタンスル ホネート、ビス (4-t-ブチルフェニル) ヨードニウ ムノナフルオローn-ブタンスルホネート、ビス(4-t ーブチルフェニル) ヨードニウムパーフルオローnーオ クタンスルホネート、ビス (4-t-ブチルフェニル) ヨードニウムpートルエンスルホネート、ビス(4-t-ブチルフェニル) ヨードニウムベンゼンスルホネート、 ビス(4-t-ブチルフェニル)ヨードニウムー2ート リフルオロメチルベンゼンスルホネート、ビス(4-t ーブチルフェニル)ヨードニウムー4ートリフルオロメ チルベンゼンスルホネート、ビス(4-t-ブチルフェ ニル) ヨードニウムー2, 4ージフルオロベンゼンスル ホネート、ビス (4-t-ブチルフェニル) ヨードニウ ムヘキサフルオロベンゼンスルホネート、ビス(4-t ーブチルフェニル) ヨードニウム10ーカンファースル ホネート、ジフェニルヨードニウムトリフルオロメタン スルホネート、ジフェニルヨードニウムノナフルオロー nーブタンスルホネート、ジフェニルヨードニウムパー フルオローnーオクタンスルホネート、ジフェニルヨー ドニウムpートルエンスルホネート、ジフェニルヨード ニウムベンゼンスルホネート、ジフェニルヨードニウム 10-カンファースルホネート、ジフェニルヨードニウ ムー2ートリフルオロメチルベンゼンスルホネート、ジ フェニルヨードニウムー4ートリフルオロメチルベンゼ 30 ンスルホネート、ジフェニルヨードニウムー2, 4ージ フルオロベンゼンスルホネート、ジフェニルヨードニウ ムヘキサフルオロベンゼンスルホネート、ジ(4-トリ フルオロメチルフェニル) ヨードニウムトリフルオロメ タンスルホネート、ジ(4-トリフルオロメチルフェニ ル) ヨードニウムノナフルオローn-ブタンスルホネー ト、ジ(4-トリフルオロメチルフェニル) ヨードニウ ムパーフルオローnーオクタンスルホネート、ジ(4-トリフルオロメチルフェニル) ヨードニウムpートルエ ンスルホネート、ジ(4ートリフルオロメチルフェニ ル) ヨードニウムベンゼンスルホネートおよびジ(4-トリフルオロメチルフェニル) ヨードニウム10-カン ファースルホネートからなる群から選択される少なくと も一種類であり、前記式(9)で表される化合物が、N - (トリフルオロメチルスルホニルオキシ) スクシンイ ・ミド、Nー(トリフルオロメチルスルホニルオキシ)フ タルイミド、Nー(トリフルオロメチルスルホニルオキ シ)ジフェニルマレイミド、Nー(トリフルオロメチル スルホニルオキシ) ビシクロ [2.2.1] ヘプト-5 ーエンー2, 3-ジカルボキシイミド、N-(トリフル 50 ルスルホニルオキシイミノ)-フェニルアセトニトリ

8 オロメチルスルホニルオキシ)ナフチルイミド、N-(10-カンファースルホニルオキシ) スクシンイミ ド、N- (10-カンファースルホニルオキシ) フタル イミド、N-(10-カンファースルホニルオキシ)ジ フェニルマレイミド、N-(10-カンファースルホニ ルオキシ) ビシクロ [2.2.1] ヘプトー5ーエンー 2, 3-ジカルボキシイミド、N-(10-カンファー スルホニルオキシ) ナフチルイミド、N- (n-オクタ ンスルホニルオキシ)ビシクロ[2.2.1]ヘプトー 10 5-エン-2, 3-ジカルボキシイミド、N- (n-オ クタンスルホニルオキシ)ナフチルイミド、N-(p-トルエンスルホニルオキシ) ビシクロ [2.2.1] へ プトー5ーエンー2, 3ージカルボキシイミド、Nー (p-トルエンスルホニルオキシ) ナフチルイミド、N - (2-トリフルオロメチルベンゼンスルホニルオキ シ) ビシクロ [2. 2. 1] ヘプト-5-エン-2, 3 ージカルボキシイミド、N-(2-トリフルオロメチル ベンゼンスルホニルオキシ)ナフチルイミド、N-(4 ートリフルオロメチルベンゼンスルホニルオキシ) ビシ クロ[2.2.1] ヘプトー5ーエンー2, 3ージカル ポキシイミド、N-(4-トリフルオロメチルベンゼン スルホニルオキシ) ナフチルイミド、N- (パーフルオ ロベンゼンスルホニルオキシ) ビシクロ [2.2.1] ヘプト-5-エン-2, 3-ジカルボキシイミド、N-(パーフルオロベンゼンスルホニルオキシ) ナフチルイ ミド、N- (1-ナフタレンスルホニルオキシ) ビシグ ロ[2.2.1] ヘプト-5-エン-2, 3-ジカルボ キシイミド、N-(1-ナフタレンスルホニルオキシ) ナフチルイミド、Nー(ノナフルオローnーブタンスル ホニルオキシ) ビシクロ [2.2.1] ヘプトー5ーエ ン-2, 3-ジカルボキシイミド、N-(ノナフルオロ -n-ブタンスルホニルオキシ) ナフチルイミド、N-(パーフルオローnーオクタンスルホニルオキシ) ビシ クロ[2.2.1] ヘプトー5ーエンー2, 3ージカル ボキシイミドおよびNー(パーフルオローnーオクタン スルホニルオキシ)ナフチルイミドからなる群から選択 される少なくとも一種類であり、前記式(10)で表さ れる化合物が、ジフェニルジスルフォン、ジ(4-メチ ルフェニル)ジスルフォン、ジナフチルジスルフォン、 40 ジ(4-t-ブチルフェニル)ジスルフォン、ジ(4-ヒドロキシフェニル)ジスルフォン、ジ(3-ヒドロキ シナフチル) ジスルフォン、ジ(4-フルオロフェニ ル) ジスルフォン、ジ(2-フルオロフェニル) ジスル フォンおよびジ(4-トルフルオロメチルフェニル)ジ スルフォンからなる群から選択される少なくとも一種類 であり、前記式(11)で表される化合物が、 $\alpha-$ (メ チルスルホニルオキシイミノ) ーフェニルアセトニトリ ル、α-(メチルスルホニルオキシイミノ)-4-メト キシフェニルアセトニトリル、αー(トリフルオロメチ

ル、 α - (トリフルオロメチルスルホニルオキシイミノ) - 4 - メトキシフェニルアセトニトリル、 α - (エチルスルホニルオキシイミノ) - 4 - メトキシフェニルアセトニトリル、 α - (プロピルスルホニルオキシイミノ) - 4 - メチルフェニルアセトニトリルおよび α - (メチルスルホニルオキシイミノ) - 4 - ブロモフェニルアセトニトリルからなる群から選択される少なくとも一種類である、請求項12に記載の組成物。

【請求項14】 請求項9に記載の化合物と、ジフェニルヨードニウムトリフルオロメタンスルホネートとを含 10 む組成物。

【請求項15】 請求項7に記載の化合物のうち少なくとも一種類と、塩基発生剤とを含む組成物。

【請求項16】 前記塩基発生剤が、光、電子線または 放射線により直接的または間接的に塩基を発生する化合 物である請求項15に記載の組成物。

【請求項17】 基板上に、請求項10から16のいずれかに記載の組成物からなるレジスト材料が形成されているレジスト基板。

【請求項18】 請求項17に記載のレジスト基板に対 20 しパターン形成したパターン形成基板。

【請求項19】 下記(a)~(c)の工程を含むパターン形成基板の製造方法。

- (a)まず、基板を準備し、次に、請求項1から9のいずれかに記載の化合物のうち少なくとも一種類と、請求項10から14のいずれかに記載の酸発生剤のうち少なくとも一種類と、それらを溶解させる溶媒とを混合させ、その混合物を前記基板上に塗布することを含むレジスト材料形成工程。
- (b) 前記レジスト材料に光、電子線または放射線を照 30 射して描画する工程。
- (c) 前記描画の後、前記レジスト材料をアルカリ現像 液を用いて現像してパターンを形成する工程。

【請求項20】 描画後、現像前に加熱処理を行う請求項19に記載のパターン形成基板の製造方法。

【請求項21】 請求項1から9のいずれかに記載の化合物のうち少なくとも一種類に代えて請求項7に記載の化合物のうち少なくとも一種類を用い、請求項10から14のいずれかに記載の酸発生剤のうち少なくとも一種類に代えて請求項15または16に記載の塩基発生剤の40うち少なくとも一種類を用いる、請求項19または20に記載のパターン形成基板の製造方法。

【請求項22】 前記化合物および前記酸発生剤を溶解 させる溶媒が、エチレングリコールモノアルキルエーテルアセテート類、エチレングリコールモノアルキルエーテル類、プロピレングリコールモノアルキルエーテルで セテート類、プロピレングリコールモノアルキルエーテル類、乳酸エステル類、脂肪族カルボン酸エステル類、およびその他のエステル類、芳香族炭化水素類、ケトン類、ならびに環状エーテル類からなる群から選択される 50

少なくとも一種類である請求項19または20に記載の パターン形成基板の製造方法。

【請求項23】エチレングリコールモノアルキルエーテルアセテート類が、エチレングリコールモノメチルエーテルアセテートおよびエチレングリコールモノエチルエーテルアセテートからなる群から選択される少なくとも一種類であり、

エチレングリコールモノアルキルエーテル類が、エチレングリコールモノメチルエーテルおよびエチレングリコールモノエチルエーテルからなる群から選択される少なくとも一種類であり、

プロピレングリコールモノアルキルエーテルアセテート 類が、プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテートおよびプロピレングリコールモノエチルエーテルアセテートからなる群から選択される少なくとも一種類であり、

プロピレングリコールモノアルキルエーテル類が、プロピレングリコールモノメチルエーテルおよびプロピレングリコールモノエチルエーテルからなる群から選択される少なくとも一種類であり、

乳酸エステル類が、乳酸メチルおよび乳酸エチルのうち 少なくとも一方であり、

脂肪族カルボン酸エステル類が、酢酸メチル、酢酸エチル、酢酸プロピルおよび酢酸ブチルからなる群から選択される少なくとも一種類であり、

その他のエステル類が、3ーメトキシプロピオン酸メチル、3ーメトキシプロピオン酸エチル、3ーエトキシプロピオン酸メチルおよび3ーエトキシプロピオン酸エチルからなる群から選択される少なくとも一種類であり、

芳香族炭化水素類が、トルエンおよびキシレンのうち少なくとも一方であり、

ケトン類が、2ーヘプタノン、3ーヘプタノン、4ーヘ プタノンおよびシクロヘキサノンからなる群から選択さ れる少なくとも一種類であり、

環状エーテル類が、テトラヒドロフランおよびジオキサンのうち少なくとも一方である、請求項22に記載のパターン形成基板の製造方法。

【請求項24】 前記アルカリ現像液が、アルカリ性化合物の水溶液、または、前記水溶液にアルコール類および界面活性剤のうち少なくとも一種類を添加した水溶液である請求項19、20、22および23のいずれかに記載のパターン形成基板の製造方法。

【請求項25】 前記アルカリ性化合物が、モノー、ジーまたはトリーアルキルアミン類、モノー、ジーまたはトリーアルカノールアミン類、複素環式アミン類、テトラメチルアンモニウムヒドロキシドおよびコリンからなる化合物群から選択される少なくとも一種類である請求項24に記載のパターン形成基板の製造方法。

【請求項26】 前記アルコール類が、メタノール、エタノールおよびイソプロピルアルコールからなる群から

選択される少なくとも一種類である請求項24または2 5に記載のパターン形成基板の製造方法。

【請求項27】 前記アルカリ性化合物水溶液の濃度が 1~10重量%である請求項24から26のいずれかに 記載のパターン形成基板の製造方法。

【請求項28】 前記アルカリ性化合物水溶液の濃度が 1~5重量%である請求項24から26のいずれかに記 載のパターン形成基板の製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、例えば、半導体製造工程中における微細パターン形成のために用いるレジスト材料(パターン形成材料)に使用可能な新規有機化合物に関する。

[0002]

【従来の技術】従来のレジスト材料(パターン形成材料)には、一般に、アモルファス薄膜を形成可能な高分子系材料が使用されている。例えば、ポリメチルメタクリレートを溶媒に溶解させ基板上に塗布して作製したパターン形成材料に、放射線を照射し、照射部を現像液で 20溶解させることにより、0.1μm程度のラインパターンが作製されている。

【0003】しかし、高分子は、分子量が大きく(1万から10万程度)、分子量分布があるため、従来の高分子系レジスト材料を用いるリソグラフィでは微細化に限界がある。すなわち、高分子系レジスト材料を用いるリソグラフィでは、微細化が進むと、パターン表面にラフネスが生じ、パターン寸法を制御することが困難となり、歩留まりが低下する。より微細なパターンを作製するためには、レジスト材料用化合物の分子サイズを小さ30くすることが一つの方法論であり、その極限が低分子系レジストである。しかし、低分子系有機化合物は、一般に結晶性が高く、アモルファス薄膜を形成することが困難であるため、レジスト材料に応用することが難しい。また、低分子系レジスト材料の例は皆無ではないが、それらの感度は低く、実用化は難しい。

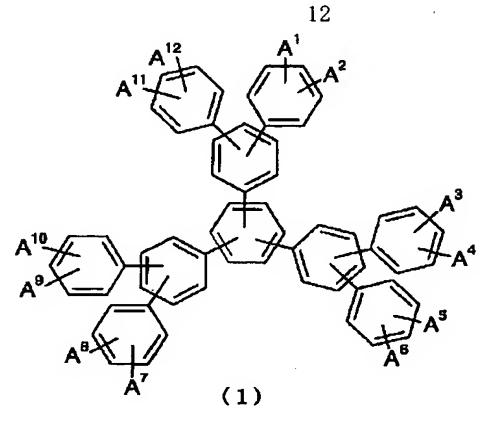
[0004]

【発明が解決しようとする課題】したがって、本発明は、例えば、高感度・高解像度パターンを作製可能なレジスト材料に使用できる新規有機化合物を提供すること 40 を目的とする。

[0005]

【課題を解決するための手段】前記課題を解決するために、本発明の有機化合物は、下記一般式(1)で表される有機化合物である。

【化10】



ただし、式中、 $A^1 \sim A^{12}$ は任意の置換基であるが、それらの中で少なくとも一つは存在し、そして、 $A^1 \sim A^{12}$ のうち少なくとも一つは酸解離性官能基である。

[0006]

【発明の実施の形態】次に、本発明の実施形態について 説明する。

【0007】(化合物)まず、本発明の有機化合物について説明する。

【0008】本発明において、前記「酸解離性官能基」とは、酸の存在下で開裂して、フェノール性水酸基、カルボキシル基等の酸性基を生じる置換基をいい、例えば、アルコキシ基、アルキルスルファニル基、アシルオキシ基、アルコキシカルボニル基、アルコキシカルボニルオキシ基、フェノキシカルボニルオキシ基等がある。前記酸解離性官能基は、さらに高感度・高解像度なパターン形成を可能にするために、酸の存在下で連鎖的に開裂反応を起こす(以下、これを「化学増幅」と呼ぶことがある)性質を有することが好ましい。

【0009】本発明の有機化合物は、ガラス状態が長期間にわたって結晶化することなく極めて安定であるという性質を有することにより、例えばレジスト材料への使用に適する。そして、例えば溶液からの塗布法、好ましくは回転塗布法により、均一・透明で室温以上で安定なアモルファスガラスを容易に形成することが可能である。本発明の有機化合物により形成されたアモルファス薄膜は、レジスト材料(パターン形成材料)として十分に機能し得る。

【0010】また、本発明の有機化合物は、高いガラス 転移温度を有しており、耐熱性に優れるという性質を有 することにより、パターン形成工程において熱処理が可 能である。

【0011】本発明の有機化合物は、高分子化合物に比べて分子サイズが極めて小さく(数百から数千程度)、さらに化学増幅を利用することにより、高感度・高解像度のパターン形成が可能である。

【0012】本発明の有機化合物において、前記式 (1)中、A'~A''が、水素および下記一般式(2) ~(4)で表される置換基からなる群から選択される少 50 なくとも一種類であることが好ましい。

(2)(3)

ただし、前記式(2)~(4)中、Yは1から12まで の整数であり、R'、R'およびR'は、Yが同一であ るA'に対応し、ここで、A'は、前記A'~A'2のいず れかであり、R¹~R¹²は、それぞれ水素、無置換もし くは置換メチル基、無置換もしくは1-置換エチル基、 無置換もしくは1-置換-n-プロピル基、1-分枝ア ルキル基、シリル基、アシル基、アルコキシカルボニル 基、無置換もしくは1-置換アルコキシメチル基、また は環状置換基であり、同一でも異なっていても良く、R ¹~R¹²はそれぞれ無置換または置換ジメチレン基で あり、同一でも異なっていても良く、R₈¹~R₈¹²はそ れぞれ電子吸引基であり、同一でも異なっていても良 く、そして、A¹~A¹²のうち少なくとも一つは水素以 外の前記原子団であり、および、R¹~R¹²のうち少な くとも一つは水素以外の前記原子団である。

【0013】前記式(2)~(4)中、R¹~R¹²にお いて、置換メチル基が、メトキシメチル基、メチルチオ メチル基、エトキシメチル基、エチルチオメチル基、メ トキシエトキシメチル基、ベンジルオキシメチル基、ベ ンジルチオメチル基、フェナシル基、4ーブロモフェナ シル基、4ーメトキシフェナシル基、ピペロニル基、メ トキシカルボニルメチル基、エトキシカルボニルメチル 基、nープロポキシカルボニルメチル基、iープロポキシ カルボニルメチル基、nーブトキシカルボニルメチル基 およびtーブトキシカルボニルメチル基からなる群から 選択される少なくとも一種類であり、1-置換エチル基 が、1-メトキシエチル基、1-メチルチオエチル基、 1, 1-ジメトキシエチル基、1-エトキシエチル基、1-エチルチオエチル基、1,1-ジエトキシエチル基、1-フェノキシエチル基、1-フェニルチオエチル基、1、1 ージフェノキシエチル基、1-シクロペンチルオキシエ チル基、1-シクロヘキシルオキシエチル基、1-フェニ ルエチル基および1,1-ジフェニルエチル基からなる群 から選択される少なくとも一種類であり、1-置換-n- 40 プロピル基が、1ーメトキシーnープロピル基および1ー エトキシーnープロピル基からなる群から選択される少 なくとも一種類であり、1-分枝アルキル基が、 i ープ ロピル基、Sec-ブチル基、t-ブチル基、1、1-ジ メチルプロピル基、1ーメチルブチル基および1,1ージ メチルブチル基からなる群から選択される少なくとも一 種類であり、シリル基が、トリメチルシリル基、エチル ジメチルシリル基、メチルジエチルシリル基、トリエチ ルシリル基、tーブチルジメチルシリル基、tーブチルジ エチルシリル基、tーブチルジフェニルシリル基、トリ

(4)

ーtーブチルシリル基およびトリフェニルシリル基から なる群から選択される少なくとも一種類であり、アシル 基が、アセチル基、フェノキシアセチル基、プロピオニ 10 ル基、ブチリル基、ヘプタノイル基、ヘキサノイル基、 バレリル基、ピバロイル基、イソバレリル基、ラウリロ イル基、ベンゾイル基およびナフトイル基からなる群か ら選択される少なくとも一種類であり、アルコキシカル ボニル基が、メトキシカルボニル基、エトキシカルボニ ル基、nープロポキシカルボニル基、iープロポキシカル ボニル基、nーブトキシカルボニル基およびtーブトキシ カルボニル基からなる群から選択される少なくとも一種 類であり、1-置換アルコキシメチル基が、1-シクロペ ンチルメトキシメチル、1-シクロペンチルエトキシメ 20 チル、1ーシクロヘキシルメトキシメチル、1ーシクロヘ キシルエトキシエチル、1-シクロオクチルメトキシメ チルおよび1ーアダマンチルメトキシメチル基からなる 群から選択される少なくとも一種類であり、環状置換基 が、シクロペンチル基、シクロヘキシル基、シクロヘキ セニル基、アダマンチル基、4-メトキシシクロヘキシ ル基、テトラヒドロピラニル基、テトラヒドロフラニル 基、テトラヒドロチオピラニル基、テトラヒドロチオフ ラニル基、4ーメトキシテトラヒドロピラニル基および 4ーメトキシテトラヒドロチオピラニル基からなる群か ら選択される少なくとも一種類であり、そして、Rペ~ R¹²が、ジメチレン基、メトキシジメチレン基、メチ ルチオジメチレン基、ジメトキシジメチレン基、エトキ シジメチレン基、エチルチオジメチレン基、ジエトキシ ジメチレン基、フェノキシジメチレン基、フェニルチオ ジメチレン基、ジフェノキシジメチレン基、シクロペン チルオキシジメチレン基、シクロヘキシルオキシジメチ レン基、フェニルジメチレン基およびジフェニルジメチ レン基からなる群から選択される少なくとも一種類であ ることがより好ましい。

【 O O 1 4 】また、前記式 (4) 中、R₈'~R₈'2が、 それぞれシアノ基、アルコキシスルホニル基、アシル 基、またはアルコキシカルボニル基であり、同一である かまたは異なることがより好ましく、R₈'~R₈'²にお いて、アルコキシスルホニル基が、メトキシスルホニル 基、エトキシスルホニル基、nープロポキシスルホニル 基、iープロポキシスルホニル基、nーブトキシスルホニ ル基およびtーブトキシスルホニル基からなる群から選 択される少なくとも一種類であり、アシル基が、アセチ ル基、フェノキシアセチル基、プロピオニル基、ブチリ 50 ル基、ヘプタノイル基、ヘキサノイル基、バレリル基、

16

ピバロイル基、イソバレリル基、ラウリロイル基、ベン ゾイル基およびナフトイル基からなる群から選択される 少なくとも一種類であり、アルコキシカルボニル基が、 メトキシカルボニル基、エトキシカルボニル基、nープ ロポキシカルボニル基、i-プロポキシカルボニル基、n ーブトキシカルボニル基およびtーブトキシカルボニル 基からなる群から選択される少なくとも一種類であるこ とがさらに好ましい。

【0015】本発明の有機化合物として特に好ましいの は、例えば、A¹~A¹²が、水素および前記一般式

(2)で表される置換基からなる群から選択される少な くとも一種類であり、R'~R'2が、水素、メトキシカ ルボニル基、エトキシカルボニル基、nープロポキシカ ルボニル基、iープロポキシカルボニル基、nーブトキシ カルボニル基、tーブトキシカルボニル基、tーブトキシ カルボニルメチル基、1-メトキシエチル基、1-エトキ シエチル基、1ーシクロヘキシルオキシエチル基、tーブ チル基、トリメチルシリル基、テトラヒドロピラニル基 および1ーシクロヘキシルメトキシメチル基からなる群 る。

【0016】上記本発明の有機化合物は、例えば、下記 一般式(5)で表されることが好ましい。

【0018】本発明の有機化合物の合成方法は特に限定 されず、公知の反応を適宜組み合せて合成することがで きるが、BCOPhTPBの場合は、例えば以下のようにして得 ることができる。すなわち、まず、1,3,5ートリス [3, 5-ジ(4-ヒドロキシフェニル)フェニル]ベン ゼンを合成する。次に、1,3,5ートリス[3,5-ジ(4-ヒドロキシフェニル)フェニル]ベンゼン50 g、ピロカルボン酸 ジターシャリーブチル エステル1 10g、炭酸カリウム80g、および100gの18-クラウンー6をテトラヒドロフランを溶媒として混合

【化12】 (5)

【0017】前記式(5)で表される化合物のうち特に 好ましいのは、例えば、下記式(6)で表される1, 3, 5ートリス[3, 5ージ(4ーターシャリーブトキ シカルボニルオキシルフェニル)フェニル]ベンゼン (以下、略して「BCOPhTPB」と呼ぶことがある)という化 合物である。BCOPhTPBは、例えば、ガラス転移温度が約 から選択される少なくとも一種類である有機化合物であ 20 140℃と高くパターン形成工程における加熱処理に十

分耐えうる等の、レジスト材料形成の用途に好ましい物

【化13】

性を有する。

し、窒素雰囲気下、室温で24時間撹拌する。そして、 溶媒を留去した後、シリカゲルカラムクロマトグラフィ により分離し、続いてエタノールから再結晶することに より目的のBCOPhTPBを得る。

【0019】 (レジスト材料) 次に、本発明の有機化合 物を用いたレジスト材料、およびそれを用いたレジスト 基板とパターン形成基板について説明する。

【0020】まず、本発明の組成物は、上記本発明の有 機化合物のうち少なくとも一種類と、酸発生剤とを含む 50 組成物であり、例えば、レジスト材料形成の用途に好適

に用いることができる。前記酸発生剤は、光、電子線ま たは放射線により直接的または間接的に酸を発生する化 合物であることが好ましい。

【0021】また、前記酸発生剤は、下記一般式(7) ~(11)で表される化合物からなる群から選択される 少なくとも一種類であることが好ましい。

【化14】

【化15】

$$R^{23}$$
 R^{24}
 R^{25}
 R^{26}
 R^{27}

【化16】

$$V < \begin{matrix} O & O & O \\ II & O & II \\ C & N - O - S - R^{28} \\ O & O & O \end{matrix}$$
(9)

【化17】

【化18】

$$R^{31}$$
 $C=N-O-S-R^{32}$ CN O

(11)

(8)

ただし、式中、R¹³~R²¹は、それぞれ水素原子、直鎖 状、分枝状もしくは環状アルキル基、直鎖状、分枝状も しくは環状アルコキシ基、ヒドロキシル基またはハロゲ 40 ン原子であり、同一でも異なっていても良く、X は、 アルキル基、アリール基、ハロゲン置換アルキル基もし くはハロゲン置換アリール基を有するスルホン酸イオ ン、またはハロゲン化物イオンであり、R²²~R²⁷は、 それぞれ水素原子、直鎖状、分枝状もしくは環状アルキ ル基、直鎖状、分枝状もしくは環状アルコキシ基、ヒド ロキシル基またはハロゲン原子であり、同一でも異なっ ていても良く、Vはアルキレン基、アリーレン基または アルコキシレン基であり、R²⁸はアルキル基、アリール 基、ハロゲン置換アルキル基またはハロゲン置換アリー 50

ル基であり、R²⁹およびR³⁰は、それぞれ、任意に置換 された直鎖、分枝もしくは環状アルキル基、任意に置換 されたアリール基、任意に置換されたヘテロアリール基 または任意に置換されたアラルキル基であり、同一でも 異なっていても良く、R³¹およびR³²は、それぞれ、任 意に置換された直鎖、分枝もしくは環状アルキル基、任 意に置換されたアリール基、任意に置換されたヘテロア リール基または任意に置換されたアラルキル基であり、 同一でも異なっていても良い。

18

10 【0022】前記本発明の組成物における酸発生剤は、 前記式(7)で表される化合物が、トリフェニルスルホ ニウムトリフルオロメタンスルホネート、トリフェニル スルホニウムノナフルオローn-ブタンスルホネート、 トリフェニルスルホニウムパーフルオローnーオクタン スルホネート、ジフェニルー4ーメチルフェニルスルホ ニウムトリフルオロメタンスルホネート、ジー2,4, 6-トリメチルフェニルスルホニウムトリフルオロメタ ンスルホネート、ジフェニルー4ーtーブトキシフェニ ルスルホニウムトリフルオロメタンスルホネート、ジフ 20 ェニルー 4 -t-ブトキシフェニルスルホニウムノナフ ルオローnーブタンスルホネート、ジフェニルー4ーヒ ドロキシフェニルスルホニウムトリフルオロメタンスル ホネート、ビス (4-フルオロフェニル) -4-ヒドロ キシフェニルスルホニウムトリフルオロメタンスルホネ ート、ジフェニルー4ーヒドロキシフェニルスルホニウ ムノナフルオローnーブタンスルホネート、ビス (4-ヒドロキシフェニル)ーフェニルスルホニウムトリフル オロメタンスルホネート、トリ(4-メトキシフェニ ル)スルホニウムトリフルオロメタンスルホネート、ト 30 リ(4-フルオロフェニル)スルホニウムトリフルオロ メタンスルホネート、トリフェニルスルホニウムpート ルエンスルホネート、トリフェニルスルホニウムベンゼ ンスルホネート、ジフェニルー2,4,6ートリメチル フェニルーpートルエンスルホネート、ジフェニルー 2、4、6-トリメチルフェニルスルホニウム-2-ト リフルオロメチルベンゼンスルホネート、ジフェニルー 2, 4, 6ートリメチルフェニルスルホニウムー4ート リフルオロメチルベンゼンスルホネート、ジフェニルー 2, 4, 6ートリメチルフェニルスルホニウムー2, 4 ージフルオロベンゼンスルホネート、ジフェニルー2, 4. 6-トリメチルフェニルスルホニウムヘキサフルオ ロベンゼンスルホネート、ジフェニルナフチルスルホニ ウムトリフルオロメタンスルホネート、ジフェニルー4 ーヒドロキシフェニルスルホニウムーpートルエンスル ホネート、トリフェニルスルホニウム10ーカンファー スルホネートおよびジフェニルー4ーヒドロキシフェニ ルスルホニウム10-カンファースルホネートからなる 群から選択される少なくとも一種類であり、前記式

(8) で表される化合物が、ビス(4-t-ブチルフェ ニル)ョードニウムトリフルオロメタンスルホネート、

ビス (4-t-ブチルフェニル) ヨードニウムノナフル オローnーブタンスルホネート、ビス(4ーtーブチルフ ェニル) ヨードニウムパーフルオローnーオクタンスル ホネート、ビス (4-t-ブチルフェニル) ヨードニウ ムpートルエンスルホネート、ビス(4-tーブチルフェ ニル) ヨードニウムベンゼンスルホネート、ビス (4t-ブチルフェニル) ヨードニウム-2-トリフルオロ メチルベンゼンスルホネート、ビス(4-t-ブチルフ エニル) ヨードニウムー4ートリフルオロメチルベンゼ ンスルホネート、ビス (4-t-ブチルフェニル) ヨー ドニウム-2, 4-ジフルオロベンゼンスルホネート、 ビス (4-t-ブチルフェニル) ヨードニウムヘキサフ ルオロベンゼンスルホネート、ビス(4-t-ブチルフ エニル) ヨードニウム10-カンファースルホネート、 ジフェニルヨードニウムトリフルオロメタンスルホネー ト、ジフェニルヨードニウムノナフルオローnーブタン スルホネート、ジフェニルヨードニウムパーフルオロー n-オクタンスルホネート、ジフェニルヨードニウムp-トルエンスルホネート、ジフェニルヨードニウムベンゼ ンスルホネート、ジフェニルヨードニウム10-カンフ 20 ァースルホネート、ジフェニルヨードニウムー2ートリ フルオロメチルベンゼンスルホネート、ジフェニルヨー ドニウムー4ートリフルオロメチルベンゼンスルホネー ト、ジフェニルヨードニウムー2, 4ージフルオロベン ゼンスルホネート、ジフェニルヨードニウムヘキサフル オロベンゼンスルホネート、ジ(4-トリフルオロメチ ルフェニル) ヨードニウムトリフルオロメタンスルホネ ート、ジ(4-トリフルオロメチルフェニル)ョードニ ウムノナフルオローnーブタンスルホネート、ジ(4-トリフルオロメチルフェニル) ヨードニウムパーフルオ 30 ローnーオクタンスルホネート、ジ(4ートリフルオロ メチルフェニル)ヨードニウムpートルエンスルホネー ト、ジ(4ートリフルオロメチルフェニル)ヨードニウ ムベンゼンスルホネートおよびジ(4-トリフルオロメ チルフェニル) ヨードニウム10-カンファースルホネ ートからなる群から選択される少なくとも一種類であ り、前記式(9)で表される化合物が、N-(トリフル オロメチルスルホニルオキシ) スクシンイミド、N-(トリフルオロメチルスルホニルオキシ) フタルイミ ド、N-(トリフルオロメチルスルホニルオキシ)ジフ エニルマレイミド、N-(トリフルオロメチルスルホニ ルオキシ) ビシクロ [2.2.1] ヘプトー5ーエンー 2, 3-ジカルボキシイミド、N-(トリフルオロメチ ルスルホニルオキシ) ナフチルイミド、N-(10-カ ンファースルホニルオキシ) スクシンイミド、N-(1 0-カンファースルホニルオキシ)フタルイミド、N-(10-カンファースルホニルオキシ) ジフェニルマレ イミド、N-(10-カンファースルホニルオキシ) ビ シクロ[2.2.1] ヘプトー5ーエンー2, 3ージカ ルボキシイミド、N-(10-カンファースルホニルオ 50

20 キシ) ナフチルイミド、N- (n-オクタンスルホニル オキシ) ビシクロ [2.2.1] ヘプトー5ーエンー 2, 3-ジカルボキシイミド、N- (n-オクタンスル ホニルオキシ) ナフチルイミド、N- (p-トルエンス ルホニルオキシ) ビシクロ [2.2.1] ヘプトー5ー エンー2, 3-ジカルボキシイミド、N- (p-トルエ ンスルホニルオキシ) ナフチルイミド、N-(2-トリ フルオロメチルベンゼンスルホニルオキシ) ビシクロ [2.2.1] ヘプト-5-エン-2, 3-ジカルボキ 10 シイミド、N-(2-トリフルオロメチルベンゼンスル ホニルオキシ) ナフチルイミド、N-(4-トリフルオ ロメチルベンゼンスルホニルオキシ)ビシクロ[2. 2. 1] ヘプト-5-エン-2, 3-ジカルポキシイミ ド、N-(4-トリフルオロメチルベンゼンスルホニル オキシ) ナフチルイミド、N-(パーフルオロベンゼン スルホニルオキシ) ビシクロ [2.2.1] ヘプトー5 -エン-2, 3-ジカルボキシイミド、N-(パーフル オロベンゼンスルホニルオキシ)ナフチルイミド、N-(1-ナフタレンスルホニルオキシ) ビシグロ[2. 2. 1] ヘプト-5-エン-2, 3-ジカルボキシイミ ド、N-(1-ナフタレンスルホニルオキシ) ナフチル イミド、N- (ノナフルオローn-ブタンスルホニルオ キシ) ビシクロ[2.2.1] ヘプトー5ーエンー2, 3ージカルボキシイミド、Nー(ノナフルオローnーブ タンスルホニルオキシ) ナフチルイミド、N-(パーフ ルオローnーオクタンスルホニルオキシ)ビシクロ [2.2.1] ヘプトー5ーエンー2, 3ージカルボキ シイミドおよびNー(パーフルオローnーオクタンスル ホニルオキシ)ナフチルイミドからなる群から選択され る少なくとも一種類であり、前記式(10)で表される 化合物が、ジフェニルジスルフォン、ジ(4-メチルフ ェニル)ジスルフォン、ジナフチルジスルフォン、ジ (4-t-ブチルフェニル) ジスルフォン、ジ (4-t ドロキシフェニル)ジスルフォン、ジ(3-ヒドロキシ ナフチル)ジスルフォン、ジ(4-フルオロフェニル) ジスルフォン、ジ(2-フルオロフェニル)ジスルフォ ンおよびジ(4-トルフルオロメチルフェニル)ジスル フォンからなる群から選択される少なくとも一種類であ り、前記式(11)で表される化合物が、 $\alpha-$ (メチル スルホニルオキシイミノ) -フェニルアセトニトリル、 α- (メチルスルホニルオキシイミノ) -4-メトキシ フェニルアセトニトリル、αー(トリフルオロメチルス ルホニルオキシイミノ) -フェニルアセトニトリル、α - (トリフルオロメチルスルホニルオキシイミノ) - 4 ーメトキシフェニルアセトニトリル、α - (エチルスル ホニルオキシイミノ) -4-メトキシフェニルアセトニ トリル、α-(プロピルスルホニルオキシイミノ)-4 ーメチルフェニルアセトニトリルおよび α ー (メチルス ルホニルオキシイミノ) -4-ブロモフェニルアセトニ

トリルからなる群から選択される少なくとも一種類であ

ることがより好ましい。

【0023】前記本発明の組成物として特に好ましいの は、例えば、前記式(6)で表される化合物BCOPhTPB と、ジフェニルヨードニウムトリフルオロメタンスルホ ネートとを含む組成物である。

【0024】本発明のレジスト基板は、基板上に、前記 本発明の組成物からなるレジスト材料が形成されている レジスト基板であり、本発明のパターン形成基板は、前 記本発明のレジスト基板に対しパターン形成したパター ン形成基板である。なお、本明細書で、「レジスト基」 板」とは、パターン形成前の基板をいい、「パターン形 成基板」とは、パターン形成後の基板をいう。また、

「パターン形成材料」とは、レジスト基板上に形成さ れ、光、電子線または放射線の照射等によりパターン形 成可能な組成物をいい、「レジスト材料」と同義であ る。

【0025】前記本発明のパターン形成基板の製造方法 は特に限定されないが、例えば、下記(a)~(c)の 工程を含む製造方法によって製造することができる。

- (a)まず、基板を準備し、次に、本発明の有機化合物 20 のうち少なくとも一種類と、前記酸発生剤のうち少なく とも一種類と、それらを溶解させる溶媒とを混合させ、 その混合物を前記基板上に塗布することを含むレジスト 材料形成工程。
- (b) 前記レジスト材料に光、電子線または放射線を照 射して描画する工程。
- (c) 前記描画の後、前記レジスト材料をアルカリ現像 液を用いて現像してパターンを形成する工程。

【0026】なお、前記工程(b)および(c)による 描画およびパターン形成の機構は、例えば以下のように 30 テート類や、プロピレングリコールモノメチルエーテ 説明される。

【0027】すなわち、前記工程(a)で形成したレジ スト材料に光、電子線または放射線を照射すると、酸発 生剤から酸が発生し、この酸が、例えば下記スキーム1 に示すように、連鎖的に酸解離性官能基を開裂させ、フ エノール性水酸基を生成させる。なお、下記スキーム1 において、Arは、酸解離性官能基(スキーム中では、 ターシャリーブトキシカルボニルオキシ基) が結合して いるアリール基である。

スキーム1

【0028】そして、照射領域は、フェノール性水酸基 50

が生成したことによりアルカリ性水溶液に可溶となり、 アルカリ性水溶液を用いることにより現像され、ポジ型 のパターンが形成される。前記スキーム1に示すような 反応を促進させるために、描画(露光)後、現像前に加 熱処理を行っても良い。

22

【0029】なお、本発明の有機化合物は、光、電子線 または放射線の照射前からフェノール性水酸基が存在し、 ていても、酸解離性官能基が存在することにより前記の ような描画(露光)および現像を行なうことが可能であ 10 る。照射後に酸解離性官能基が開裂して新たにフェノー ル性水酸基が生成し、照射前と比較してアルカリ水溶液 に対する溶解度が増大するからである。この場合、照射 前と照射後とのアルカリ水溶液に対する溶解度の差がな るべく大きいことが好ましい。なお、照射前からフェノ ール性水酸基が存在していると、シリコン基板等の極性 が高い材料との接着性が良く好ましい場合がある。前記 BCOPhTPB等は、フェノール性水酸基を有しないが、シリ コン基板との接着性は良好である。

【0030】前記工程(a)で使用する溶媒は、本発明 の有機化合物および酸発生剤を溶解させるものであれば 特に限定されないが、例えば、エチレングリコールモノ メチルエーテルアセテート、エチレングリコールモノエ チルエーテルアセテート等のエチレングリコールモノア ルキルエーテルアセテート類や、エチレングリコールモ ノメチルエーテル、エチレングリコールモノエチルエー テル等のエチレングリコールモノアルキルエーテル類 や、プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテー ト、プロピレングリコールモノエチルエーテルアセテー 卜等のプロピレングリコールモノアルキルエーテルアセ ル、プロピレングリコールモノエチルエーテル等のプロ ピレングリコールモノアルキルエーテル類や、乳酸メチ ル、乳酸エチル等の乳酸エステル類や、酢酸メチル、酢 酸エチル、酢酸プロピル、酢酸ブチル等の脂肪族カルボ ン酸エステル類や、3-メトキシプロピオン酸メチル、 3-メトキシプロピオン酸エチル、3-エトキシプロピ オン酸メチル、3-エトキシプロピオン酸エチル等の他 のエステル類や、トルエン、キシレン等の芳香族炭化水 素類や、2-ヘプタノン、3-ヘプタノン、4-ヘプタ 40 ノン、シクロヘキサノン等のケトン類や、テトラヒドロ フラン、ジオキサン等の環状エーテル類が好ましい。こ れらの溶媒は、単独で使用しても良いし、2種以上混合 して使用しても良い。また、アルカリ現像液としては、 例えば、モノー、ジーあるいはトリーアルキルアミン 類、モノー、ジーあるいはトリーアルカノールアミン 類、複素環式アミン類、テトラメチルアンモニウムヒド ロキシド、コリン等のアルカリ性化合物の少なくとも1 種を、好ましくは、1~10重量%、より好ましくは1 ~5 重量%の濃度となるように溶解したアルカリ性水溶 液が好ましく使用できる。また、前記アルカリ現像液に

は、メタノール、エタノール、イソプロピルアルコール 等のアルコール類や界面活性剤を適量添加することもで きる。

【0031】なお、本発明の有機化合物において、A'~A'*が、水素および前記一般式(4)で表される置換基からなる群から選択される少なくとも一種類である場合は、前記組成物およびレジスト材料で、酸発生剤に代えて塩基発生剤を用いることができる。前記塩基発生剤は、光、電子線または放射線により直接的または間接的に塩基を発生する化合物であることが好ましい。このと 10

き、前記工程(a)~(c)において、酸発生剤に代えて塩基発生剤を用いてパターン形成基板を製造することができる。前記一般式(4)で表される置換基は、塩基により、例えば下記スキーム2のような機構で開裂してフェノール性水酸基を生成する。なお、下記スキーム2において、Arは、前記置換基(スキーム中では、2ーシアノエトキシカルボニルオキシ基)が結合しているアリール基である。

24

【化20]

Ar-O-C-O-C-C-C-C-O- +
$$H_2$$
C=CH

Base:

Base:

スキーム2

【0032】本発明の有機化合物によれば、例えば、約 2μ C/c m² の極めて高い感度を有するパターン形成材料をレジスト基板上に形成することができる。そして、そのパターン形成材料を用いて、25nmの極めて微細なラインパターンを、表面のラフネスを発生させることなく形成し、パターン形成基板を製造することも可能である。したがって、本発明のパターン形成基板によれば、集積度の高い半導体素子を作製することが可能になる。

[0033]

【実施例】次に、本発明の実施例について説明する。 【0034】 (測定法) 核磁気共鳴 (NMR) スペクト

【0034】 (測定法) 核磁気共鳴 (NMR) スペクトルは、商品名Inova-750 (Varian社、「H測定時750MHz) または商品名Inova-600 (Varian社、「H測定時600MHz) を用いて測定した。ケミカルシフトは百万分率 (ppm) で表している。内部標準0ppmには、テトラメチルシラン (TMS) を用いた。結合定数 (J) は、ヘルツで示しており、略号s、d、t、q、mおよびbrは、それぞれ、一重線(singlet)、二重線 (doublet)、三重線(triplet)、四重線(quartet)、多重線(multiplet)および広幅線(broad)を表す。質量分析

(MS) は、商品名JEOL JMS-DX303 (JEOL社)を用い、EI 法またはFAB法により行った。元素分析は、商品名CHN c order MT-5 (柳本製作所)を用いて行った。カラムクロマトグラフィー分離には、シリカゲル(商品名ワコーゲルC-300、和光純薬工業株式会社)を用いた。全ての化学物質は、試薬級であり、東京化成工業株式会社、和光純薬工業株式会社、ナカライテスク株式会社、関東化学株式会社およびAldrich社から購入した。

【0035】 (BCOPhTPBの合成) 以下のステップ1~5 50

にしたがって、BCOPhTPBを合成した。

【0036】1. 3,5-ジブロモアセトフェノンの合成 以下のようにして3,5-ジブロモアセトフェノンを得た。 すなわち、まず、1,3,5-トリブロモベンゼン(10g, 31. 7 mmol) をジエチルエーテル (250 ml) に溶解させ、-7 8 ℃に冷却した。次に、この溶液に、n-ブチルリチウム のn-ヘキサン溶液 (1.6 mol dm³, 19.8 ml, 31.7 mmo 1) を加え、-78℃において 1 時間攪拌した後、N, N-ジメ チルアセトアミド (3.03 g, 34.8 mmol)を加えた。そし 30 て、徐々に室温に戻し、室温において12時間攪拌した。 さらに、10% 塩酸水溶液を加えて反応を停止させ、有機 溶媒で抽出した。溶媒を除去したのち、シリカゲルカラ ムクロマトグラフィー (展開溶媒:ヘキサン)により分 離し、続いてメタノールから再結晶し精製して目的物を 得た(収量:3.1g、収率:35 %)。融点:62 ℃。 H NMR (750 MHz, CDCl₃, 25 °C): δ (ppm) = 7.979 (1H, s), 7,976 (1H, s), 7.835 (1H, s), 2.564 (3H, s). 【0037】2. 1,3,5-トリス(3,5-ジブロモフェニ

【0037】2. 1,3,5-トリス(3,5-シブロモフェニル)ベンゼンの合成 以下のようにして1.2.5-トリス(2.5-ジブロエフェニル

40 以下のようにして1,3,5-トリス(3,5-ジブロモフェニル) ベンゼンを得た。すなわち、まず、3,5-ジブロモアセトフェノン(10g,36 mmol)とトリフルオロメタンスルホン酸(1.4 ml)をトルエンに溶解させ、還流温度で24時間攪拌した。そして、溶媒を除去したのち、シリカゲルカラムクロマトグラフィー(展開溶媒:トルエン/ヘキサン)で分離し、続いてテトラヒドロフラン/ヘキサン混合溶媒からの再結晶により精製して目的物を得た(収量:2.4 g、収率:25 %)。質量分析(EI):m/e = 780(M⁺)。

【0038】3. 1,3,5-トリス[3,5-ビス(4-メトキシ

フェニル)フェニル]ベンゼンの合成

以下のようにして1,3,5-トリス[3,5-ビス(4-メトキシフェニル)フェニル]ベンゼンを得た。すなわち、まず、1,3,5-トリス(3,5-ジブロモフェニル)ベンゼン(1.4 g,1.8mmol) および4-メトキシボロン酸(2.5 g,16.1 mmol) を含むテトラヒドロフランに、テトラキス(トリフェニルホスフィン)パラジウム(0)(0.35 g,0.3 mmol) および炭酸カリウム水溶液を加え、還流温度において12時間攪拌した。そして、有機層を水で洗浄し、乾燥させた。溶媒を除去し、シリカゲルカラムクロマトグラフィ10ー(展開溶媒:トルエン/酢酸エチル)で分離し、続いてトルエン/酢酸エチル混合溶媒からの再結晶により精製して目的物を得た(収量:1.1 g、収率:65 %)。質量分析(EI):m/e = 942 (M)。

【0039】4. 1,3,5-トリス[3,5-ビス(4-ヒドロキシフェニル)フェニル]ベンゼンの合成以下のようにして1,3,5-トリス[3,5-ビス(4-ヒドロキシフェニル)フェニル]ベンゼンを得た。すなわち、まず、1,3,5-トリス[3,5-ビス(4-メトキシフェニル)フェニル]ベンゼン(1.4 g, 1.4 mmol)および臭化水素酸(500 m 201)を含む酢酸溶液を、還流温度において12時間攪拌した。そして、溶媒を除去し、生成物を水で洗浄した後、減圧下で乾燥して目的物を得た(収量:0.9 g、収率:75%)。質量分析(EI):m/e = 859 (M)。

【0040】5. BCOPhTPBの合成

以下のようにしてBCOPhTPBを得た。すなわち、まず、1, 3, 5-トリス[3, 5-ビス(4-ヒドロキシフェニル)フェニル] ベンゼン (0.5 g, 0.6 mmol)、ピロカルボン酸 ジータ ーシャリーブチル エステル(1.1 g, 0.5 mmol)、炭酸カ リウム (0.8 g, 5.7 mmol)、および、18-クラウン-6 エ 30 ーテル (1.0 g, 3.8 mmol) をテトラヒドロフランに溶 解させ、40℃において10時間攪拌した。そして、反応 物を抽出し、シリカゲルカラムクロマトグラフィー(展 開溶媒:酢酸エチル)で分離し、続いてテトラヒドロフ ラン/メタノール混合溶媒からの再結晶により精製して 目的物を得た(収量:0.4 g、収率:54%)。質量分析(F AB): $m/e = 1460 \, (MH^{\dagger})_{o}^{1} \, H \, NMR \, (600 \, MHz, \, CDCl_{3}, \, 25)$ °C) δ (ppm) = 7.95 (3H, s), 7.85 (6H, s), 7.76 (3 H, s), 7.70 (12H, d), 7.28 (12H, d), 1.58 (54H, s), 13 C NMR (150 MHz, CDCl₃, 25 °C) δ (ppm) = 15 0. 8, 150. 7, 142. 6, 142. 2, 141. 8, 138. 6, 128. 4, 128. 3, 125.9, 125., 125.4, 121.7, 83.7, 27.7。元素分

析:計算値(C, 0H, 0O, 8): C, 74.06; H, 6.21; O, 19.7 3. 実測値: C, 73.96; H, 6.33。

26

【0041】(レジスト材料)次に、合成したBCOPhTPBを用いてレジスト材料を形成し、これを用いてレジスト基板およびパターン形成基板を作製して性能を評価した。すなわち、まず、BCOPhTPB5gおよびジフェニルヨードニウムトリフルオロメタンスルホネート(酸発生剤)0.1gをテトラヒドロフラン100gに溶解させた。そして、この溶液をシリコン基板上に回転塗布することにより、膜厚 0.2μ mのアモルファス薄膜からなるレジスト材料を前記シリコン基板上に形成してレジスト基板を作製した。

【0042】次に、前記シリコン基板上に形成されたレジスト材料に対して50keVの電子線を照射しラインパターンを描いた。

【0043】その後、約100℃で約90秒間加熱処理を行った後、テトラメチルアンモニウムヒドロキシド水溶液とイソプロピルアルコール混合溶媒にて約30秒の現像を行い、電子線が露光された領域を除去し、脱イオン水で約20秒リンスしてパターン形成基板を作製した。

【0044】図1に、本実施例のレジスト材料における 感度曲線を示す。図示の通り、感度は約 2μ C/c m² で あり、実用レベルの高い感度を有していた。

【0045】図2に、本実施例のパターン形成基板におけるラインパターンの顕微鏡写真を示す。図示の通り、このラインパターンは線幅が25nmと高解像度であり、極めてラフネスの少ない良好なパターン形状を有していた。

[0046]

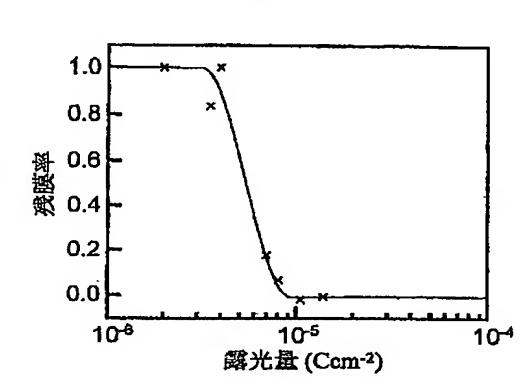
【発明の効果】以上説明した通り、本発明の新規有機化合物を使用すれば、高感度・高解像度パターンを作製可能なレジスト材料を形成することができる。本発明に係る化学増幅型低分子系レジスト材料を用いることにより、極めてラフネスの少ない高解像度のパターンを高感度で作製することが可能となるため、集積度の高い半導体素子を作製することが可能となる。

【図面の簡単な説明】

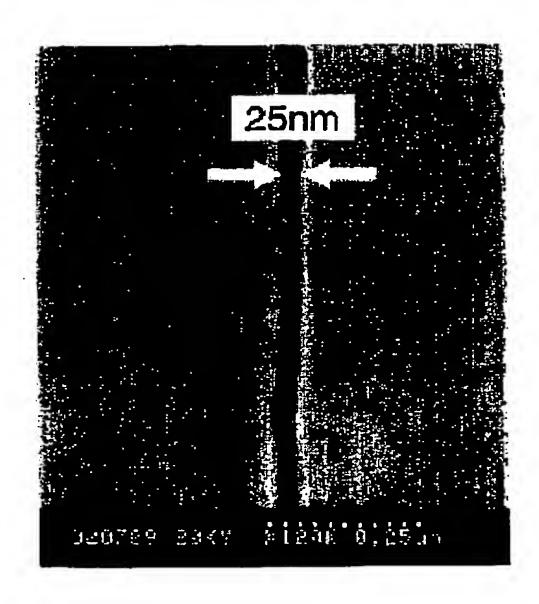
【図1】本発明のレジスト材料の一例における感度曲線 40 を示すグラフである。

【図2】本発明のパターン形成基板の一例におけるラインパターンの顕微鏡写真である。

【図1】



【図2】



フロントページの続き

(72) 発明者 門田 敏明

大阪府吹田市千里山東3-5-19 ユニワ エクセル410号室

Fターム(参考) 2H025 AA01 AA02 AB16 AC06 AD03 BE10 CC20 FA03 FA12 FA17 4H006 AA01 AA03 AB80 BJ50

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:
BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
☐ FADED TEXT OR DRAWING
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
OTHER:

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.